



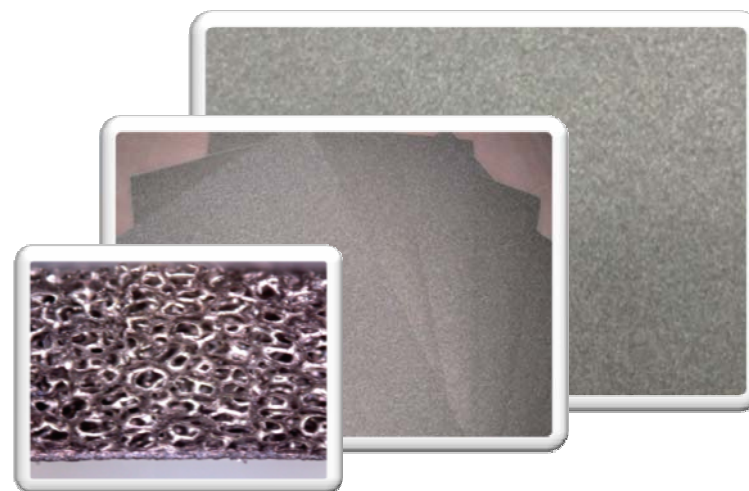
導電海綿(Conductive Sponge)

緩衝及接地-SELIDCCD系列

SELIDCCD 導電軟墊是聚氨酯發泡材鍍上銅-鎳，彈斥力是非常低的，並且具有非常優異的接地性能。



Ni - Cu - Ni plating + ATU



應用例

- 各式電子元件
- 行動手機
- 平板電腦

參考例

- 宏達電(HTC) 智慧手機
- TOMTOM 導航機



導電海綿(Conductive Sponge)

緩衝及接地-SELIDCCD系列

項目	單位	規格	註記
顏色	-	灰色(Gray)	可視的(Visual)
孔數(Pore count)	ppi	80	ppi : Pixel per inch
厚度	mm	0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0	-
公差	mm	0.3, 0.5, 0.7 \pm 0.1 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 \pm 20%	-
寬度	mm	500	-
表面阻抗	Ω/\square	Max 0.1	MIL-DTL-83528C/Foam Side
接觸阻抗	Ω/in^2	Max 0.1	Doosung Test Method
黏著力	gf/25mm	Min 1,000	KS T 1028
遮蔽力	dB	Min 70	ASTM D 4935
RoHs, 無鹵素	ppm	pass	-
溫度範圍	$^{\circ}\text{C}$	-10~80	-